



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

### 【1. 適用範囲 SCOPE】

-	/ <b>_</b> +++=	<b>⇒</b> /-
<i>'</i>	仕様	手しよ、

殿 に納入する

<u>0.635mm ピッチ基板対基板用コネクタ</u>について規定する。

This specification covers the 0.635mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series.

### 【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND MATERIAL NUMBER】

	製 品 名 称 Product Name			製 品 型 番 Material Number
	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	52883-**70
	H=4mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	52883-**92
リセプタクル アッセンブリ	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	52760-**70
Receptacle Assembly	H=5-10mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	52885-**72
	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	52837-**70
	Stacking Height H=11-16mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	52901-**72
	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53623-**71
	H=4mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53623-**72
	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53475-**70
	H=5,11mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53643-**72
プラグ アッセンブリ Plug Assembly	嵌合高さ Stacking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	55091-**71
	H=6,12mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	55091-**72
	嵌合高さ	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53481-**67
	歌音高さ Stacking Height H=7,13mm	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53481-**77
	11-7,10111111	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53625-**72

	REV.	Α	В	С	D	Е														
	SHEET	1~11	1~11	1~11	1~11	1~11														
		REVI	SE OI	N PC	ONL	/		TITLE	:											
				変	更					0.			ITCH			_	1.			
				REVI	SED						H	JUS	ING A	SSE	MBL	Y				
	<b>L</b> J2008-1										-LE	AD FI	REE-			製品	品仕	様書		
		70	7/10/	16 R.	SUR	UOKA	1	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO												
	REV.		DE	SCR	PTIO	Ν		MOLE	X INC.	AND S	HOULD	NOT	BE USI	ED WI	THOUT	WRIT	TEN PI	ERMI	SSION	
	DESI	GN C	ONTF	ROL	S	TATU	S		TTEN	CH	HECKE	D	APPRO		I	DATE	: YR/N	MO/E	ΑY	
	J				N.A	Y: .IDA	۲	BY: (.TOJO		BY M.SAS	-		200	04/03	3/01					
DOC	DOCUMENT NUMBER											F	ILE N	AME		SHEE	T			
	PS-52760-015										PS	527600	15.doc	;	1 OF 1	11				
																		Ε	N-37(0)	)19





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

	製 品 型 番 Material Number			
	嵌合高さ Stocking Height	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53551-**77
	H=8,14mm	acking Height H=8,14mm With Cover LEAD FREE 5	53647-***9	
プラグ アッセンブリ	嵌合高さ Ctacking Unight	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53552-***6
Plug Assembly	Stacking Height H=9,15mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53649-**72
	嵌合高さ Ctacking Unight	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	53553-**77
	Stacking Height H=10,16mm	吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	53627-**72

\*\*\*:極数(添付図面参照)

CKTS(Refer to the drawing)

ー\*\*68:吸着カバー無しエンボス梱包

EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER

ー\*\*74:吸着カバー付きエンボス梱包

EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER

ー\*\*75:吸着カバー付きステイック梱包

STICK PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER

ー\*\*76:吸着カバー無しトレー梱包

TRAY PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER

53551-\*\*77のトレー梱包品は、53936-\*\*76です。

-\*\*78:吸着カバ-無しエンボス梱包

EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER

52760-\*\*70のエンボス梱包品は、54914-\*\*78です。

ー\*\*79:吸着カバー無しステイック梱包

STICK PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER

ー\*\*94:吸着カバー付きエンボス梱包

EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER

#### 【3. 定格 RATINGS】

項 目 Item	規 Stan	格 dard
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	100 V	[AC(実効値 rms)/DC]
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5 A	[AC(关划恒 IIIIS//DC]
使用温度範囲 Ambient Temperature Range (Operating and Non-operating)	-55°C ~	+85°C <sup>*1</sup>

\*1: 通電による温度上昇分を含む。 Including terminal temperature rise

	ſ	REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	Ε	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO HOUSING ASSEN -LEAD FREE	MBLY	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		IUMBER		FILE NAME	SHEET
	•	0 02/00 0/0		PS52760015.doc	2 OF 11





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

### 【4. 性 能 PERFORMANCE】

### 4-1. 電気的性能 Electrical Performance

	項 目 Item	条 件 Test Condition	嵌合高さ Stacking Height	規 格 Requirement
		適合するコネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV	H= 4 - 7mm	40 milliohm MAXIMUM
4-1-1	接触抵抗 Contact	以下、短絡電流 10mA以下 にて測定する。 触 抵 抗 (JIS C5402 5.4)		50 milliohm MAXIMUM
4-1-1	Resistance	Mate applicable connectors, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM.	H= 11 -13mm	60 milliohm MAXIMUM
		(JIS C5402 5.4)	H= 14 -16mm	70 milliohm MAXIMUM
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	適合するコネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 250Vを印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302)  Mate applicable connectors together and apply 250V DC between adjacent terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohm	n MINIMUM
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	適合するコネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC 250V (実効値)を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable connectors, apply 250V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なる No Breal	

#### <u>4-2. 機械的性能 Mechanical Performance</u>

項 目		条 件		規 格
Item		Test Condition		Requirement
插入• 抜去力	毎分 25±3 mm の速さで挿入、	挿入力	0.690N {70gf} / CIRCUIT	
	抜去を行う。	Insertion Force	MAXIMUM	
4-2-1	Insertion Force/ Withdrawal Force	Insert and withdraw connectors, at a rate of 25±3mm/minute.	抜去力 Withdrawal Force	0.118N {12gf} / CIRCUIT MINIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO HOUSING ASSET -LEAD FREE	MBLY	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOC	UMENT I	NUMBER <b>S-52760-015</b>		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 3 OF 11
			-1	EN-	37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal Pull-out Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引っ張る。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing at a rate of 25±3mm/ minute.	52883-**70 52883-**92 52760-**70 52885-**72 52837-**70 52901-**72 55091-**71 55091-**72 53481-**77 53625-**72 53551-**77 53647-***9 53552-***6 53649-**72 53553-**77 53627-**72	1.96 N { 0.2kgf } MINIMUM 3.9 N { 0.4kgf }
			53553-* 53627-*	**77 **72 **72 **72 **70

### 4-3. その他 Environmental Performance and Others

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	1分間 に 10回以下 の速さで挿入、抜去を 50回 繰り返す。 When mate / un-mated up to 50 cycles repeatedly at a rate of 10 cycles / minute.	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合するコネクタを嵌合させ、最大許容電流 を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate applicable connectors and measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30°C MAXIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO HOUSING ASSET -LEAD FREE	MBLY	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOC	CUMENT I	NUMBER S-52760-015		FILE NAME	SHEET
				PS52760015.doc	4 OF 11
				FN-	37-1(019)





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
		DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な3方向に掃引割合 10~55~10Hz/分、	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。 (MIL-STD-202試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. Amplitude: 1.5mm P-P	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
		Frequency: 10-55-10Hz (MIL-STD-202, Method 201)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
4-3-4	耐衝擊性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに 垂直な 6方向 に、パルス幅 11ms 衝撃波形が 正弦半波 490m/s <sup>2</sup> {50G} の衝撃を 各3回 加 える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
		(JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213)  Mate applicable connectors and subject to the following shock conditions. 3 times of shocks	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
		Test pulse : Half Sine Peak value : 490m/s² {50G} Duration : 11ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM

		EVISE ON PC ONLY TITLE:			
E SEE SHEET 1 OF 11		SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH		
DO	CUMENT I	NUMBER <b>PS-52760-015</b>	FILE NAME SH		SHEET
	1 0-32700-013			PS52760015.doc	5 OF 11
FN-37-1(0				37-1(019)	





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
425	耐熱性	適合するコネクタを嵌合させ、85±2℃ の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate applicable connectors and expose to	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-5	明 表代 1生 Heat Resistance	85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	適合するコネクタを嵌合させ、-55±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate applicable connectors and expose to -55±3°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
	Ε	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH		
DOC	UMENT I	NUMBER <b>S-52760-015</b>	THE WAVE		SHEET 6 OF 11
EN-37-1(01)					





LANGUAGE

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
		適合するコネクタを嵌合させ、60±2℃、相	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
4-3-7	耐湿性 Humidity	対湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し、1~2時間 室温に放置する。(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法103)  Mate applicable connectors and expose to 60±2°C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
		conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohm MINIMUM
4-3-8	温度サイクル B Temperature Cycling	適合するコネクタを嵌合させ、-55±3℃に30分、+85±2℃に30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は、3分以内とする。試験後1~2時間室温に放置する。(JISC0025)  Mate applicable connectors and subject to the following conditions for 5 cycles Upon	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
		the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOC	UMENT I	NUMBER S-52760-015	FILE NAME SHE		SHEET
1 0 32700 013		0 021 00 010		PS52760015.doc	7 OF 11
	EN-37-1(019)				





LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition		格 quirement
		適合するコネクタを嵌合させ、35±2℃にて、重量比 5±1% の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
	塩水噴霧	Mate applicable connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon		
4-3-9	塩水項務 Salt Spray	completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1 % Spray time: 48±4 hours Ambient temperature:35±2°C (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
4-3-10	亜硫酸ガス SO <sub>2</sub> Gas	適合するコネクタを嵌合させ、40±2℃にて、50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。  Mate applicable connectors and expose to 50±5ppm SO <sub>2</sub> gas, ambient temperature 40±2℃ for 24 hours.	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement: 20 milliohm MAXIMUM
4-3-11	半田付け性 Solder-ability	端子先端より 0.5mm の位置まで 245±3°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Dip soldertails into the molten solder {held at 245±3°C} up to 0.5mm from the bottom of the housing for 3±0.5 seconds.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes

REVISE ON PC ONLY		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOC	DOCUMENT NUMBER PS-52760-015 FILE NAME PS52760015.doc		SHEET 8 OF 11		
EN-37-1(01)				37-1(019)	





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-12	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロ一時) 第6項の条件にて、2回リフローを行う。 (When reflowing) Repeat paragraph 6, two times. (手半田) 端子先端より 0.5mm、金具先端より 0.5mm の位置まで 370~400°C の半田ゴテにて 最大5秒 加熱する。 (Soldering iron method) 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip. Soldering time : 5 seconds MAX.	外 観 Appearance	端子ガタ 割れ等 異状無きこと No Damage
		Solder temperature : 370~400°C		

(	):参考規格	Reference Standard
{	}: 参考単位	Reference Unit

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】 図面参照 Refer to the drawing.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	Ε	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	UMENT I	NUMBER <b>S-52760-015</b>	TILL TO MALE		SHEET
1 0 02/00 010		<u> </u>		PS52760015.doc	9 OF 11
	EN-37-1(019)				

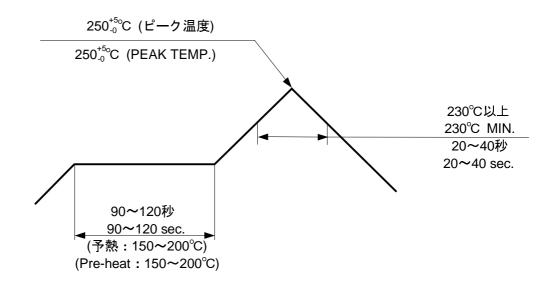




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

#### 【6. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



#### 温度条件グラフ (温度は基板パターン面)

# TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記: 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、

事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

NOTE; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

REVISE ON PC ONLY TI			TITLE:		
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH		-
DO	CUMENT I	NUMBER PS-52760-015	THE WAVE OF S		SHEET 10.0F.11
				PS52760015.doc	10 OF 11
				FN-	37-1(019)





LANGUAGE

REV.	REV. RECORD	DATE	ECN NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
А	RELEASED	'04/03/01	J2004-2758	N.AIDA	K.TOJO
В	REVISED	'04/04/23	J2004-3983	E.SUZUKI	K.TOJO
С	REVISED	'05/01/19	J2005-2076	N.AIDA	K.TOJO
D	REVISED	'05/02/24	J2005-2773	N.AIDA	K.TOJO
Е	REVISED	'07/10/16	J2008-1357	R.TSURUOKA	T.HARUYAMA
		1			

REVISE ON PC ONLY			TITLE:				
	E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015				FILE NAME	SHEET		
. 5 52. 66 616				PS52760015.doc	11 OF 11		
FN-37-1(019)							